

# 苏州国芯科技股份有限公司

## 2023 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2023-010

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
<b>参与单位名称</b>	摩根士丹利基金；
<b>时间</b>	2023 年 9 月 1 日 16: 00;
<b>地点</b>	线上网络交流
<b>上市公司参加人员姓名</b>	董事会秘书：黄涛先生；
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p style="text-align: center;"><b>1、公司 2023 年下半年的发展重点是什么？</b></p> <p>答：2023 年下半年，公司将继续坚守长期主义的发展策略，抓住 CPU 国产替代的发展机遇，重点发展汽车电子、AI 服务器与边缘计算等相关的自主芯片业务（包括 Raid 芯片、CCP1080T 等），紧抓在手订单的执行工作，继续开拓新的产品和订单，持续推进 12 条汽车电子芯片产品线的市场拓展和产品研发，助力公司高质量发展，促进公司业务做大做强。</p> <p style="text-align: center;"><b>2、请说明一下公司的在手订单情况？</b></p> <p>答：截至 2023 年 6 月 30 日，公司的在手订单金额为 5.43 亿元。按照应用领域来划分，汽车电子和工业控制业务的在手订单金额为 0.73 亿元，信创和信息安全业务的在手订单金额为 0.57 亿元，边缘计算（高性能计算）和人工智能业务的在手订单为 4.13 亿元。下半年，公司会继续开拓新的订单，并加强在手订单的执行工作，做好技术支持服务和产能的保障工作，尽最大努力促进业务按约定推进。</p> <p style="text-align: center;"><b>3、公司汽车电子业务接下来发展的重点是什么？</b></p>

答：公司汽车电子芯片已陆续进入比亚迪、奇瑞、吉利、上汽、长安、长城、一汽、东风、小鹏等众多汽车整机厂商，在 20 余款自主及合资品牌汽车上实现批量应用。截至 2023 年 6 月 30 日，已量产的汽车电子项目数（个）达到 13 个，新开发的汽车电子项目数（个）达到 56 个。接下来，公司将继续集中力量做好新项目的开发工作，着力攻坚头部重点客户、重点项目，尽可能实现项目的快速量产。

#### **4、公司的在安全气囊芯片领域的进展情况怎么样？**

答：2022 年公司研发成功了 CCFC2012BC 芯片，可用于安全气囊主控应用。面对市场急需，公司启动了安全气囊点火驱动芯片 CCL1600B 芯片的研发工作，目前芯片内测成功。安全气囊点火驱动芯片 CCL1600B 芯片和安全气囊主控芯片 CCFC2012BC 可以组成高度紧凑的双芯片安全气囊 ECU。安全气囊点火驱动芯片 CCL1600B 芯片将电源模块、触发回路模块、传感器接口模块和复杂的安全模块集成在一个芯片上，该款产品目前已在多家气囊控制器厂商进行产品开发和测试，该款芯片与公司已经批量装车超过百万颗规模的气囊控制 MCU 形成双芯片方案优势，市场前景良好。

#### **5、请问公司汽车电子领域未来有哪些研发及应用可以期待？**

答：（1）在汽车动力总成控制芯片上，CCFC3008PT 芯片产品是基于公司自主 PowerPC 架构 C\*Core CPU 内核研发的新一代适用于汽车电子动力总成、底盘控制器、动力电池控制器以及高集成度域控制器等应用的多核 MCU 芯片，是基于客户更高算力、更高信息安全等级和更高功能安全等级应用需求而开发的全新多核架构芯片。对标 NXP（恩智浦）MPC5777 的高端动力总成控制芯片产品 CCFC3007PT 已完成设计，正在流片中，可覆盖传统的汽柴油发动机、新型混动发动机及电动机应用需求；（2）在底盘应用领域，主要 MCU 芯片产品系列有：CCFC2012BC/CCFC2011BC/CCFC2016BC/CCFC2017BC/CCFC3008PT 和 CCFC3007PT。为方便客户底盘方案实现，公司还开发了多通道的传感器 PSI5 接口协议收发器芯片 CIP4100B，以降低客户的方案 BOM 成本，并将于年内量产；（3）在汽车域控制芯片领域，公司高端的域控制芯片 CCFC3007PT、CCFC3008PT 和 CCFC3009PT 系列都是采用与客户联合开发或者面向主要客户关键需求进行开发。目前 CCFC3008PT 芯片内部测试成功，已经支持多家 Tier1 客户开展域控制器产品开发；（4）在新能源电池管理（BMS）芯片领域，公司新一代高性能新能源电池管理控制芯片 CCFC3008PT 内部测试成功，已送样给相关模组厂商进行评估和开发测试；（5）在车规级安全 MCU 芯片领域，公司基于

客户需求开发了新一代汽车信息安全芯片产品 CCM3305S，该款芯片支持通信接口 USB3.0，对称算法在端口处实现同时接受和发送超过 200Mbps；（6）在汽车电子混合信号类芯片领域，面对国产替代的机会，公司启动了桥接与预驱专用芯片 CCL1100B 芯片和 NFC 射频收发芯片的研发工作，目前进展顺利。桥接与预驱专用芯片 CCL1100B 芯片是面向车门、窗、后视镜的执行器使用的桥接与预驱专用芯片。面向汽车 PEPS（无钥匙进入）应用，公司开发了首款 NFC 射频收发芯片 CNF7160。桥接与预驱专用芯片 CCL1100B 芯片和 NFC 射频收发芯片的研发进一步丰富了公司的汽车电子产品线，有助于公司从 MCU 系列产品线拓宽到模数混合专用芯片领域；（7）在汽车电子专用 SoC 芯片领域，公司正在开展新能源汽车降噪 SoC 芯片 CCD5001 芯片的研发工作，该产品可广泛用于汽车音频放大器、音响主机、ANC/RNC、后座娱乐、数字驾驶舱和 ADAS，该类芯片市场目前完全被国外公司垄断。公司拟采用 12nm 先进工艺设计，实现芯片性能功耗双提升和打破国外公司垄断局面；（8）在汽车辅助驾驶芯片领域，公司 CCFC3009PT 芯片处于设计中，是公司面向辅助驾驶领域设计开发的第一款芯片，主要面向 ISP 及毫米波雷达信号的后处理，采用多核 RISC-V 架构的公司自研 CPU 核 CRV4H，算力可以达到 2700DMIS，同时内嵌雷达信号预处理等模块；（9）在智能传感芯片领域，公司正在进行加速度测量的智能传感器芯片研发，目前开发的加速度传感器芯片 CMA2100B 包含 MEMS 和传感器 ASIC 芯片两部分。MEMS 用于加速度感知转化成电气参数变化，而 ASIC 把电气参数变化转化成数字信号，接着经过数字后处理单元，最终通过 PSI5 接口传给 ECU 模组，实现加速度感知到控制的目标。

#### **6、公司 Raid 控制芯片及板卡的研发、市场开拓进展怎么样？**

答：公司成功研发 Raid 控制芯片 CCRD3316，该芯片是在原有第一代 Raid 控制芯片客户验证和使用反馈的基础上，进行完善和优化设计的改进量产版产品。在 CCRD3316 内部测试成功基础上，根据市场反馈，积极完善 Raid 卡方案，加强技术支持服务团队，相关 Raid 卡方案已经在重点客户进行应用测试，在首批应用客户测试的基础上，将进一步拓展到主要的服务器行业厂商。

同时，公司正在基于自主高性能 RISC-V CPU 研制开发第二代更高性能的 Raid 芯片，目前各项工作进展顺利，未来有望达到国际主流 Raid 芯片的性能。Raid 芯片是服务器中广泛应用的一个重要芯片产品，长期以来被国外公司垄断，急需实现国产化替代。

附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 9 月